

日本CMK

営業利益が3.2倍に

タイ工場能力を増強

国内基板メーカー大手の日本シイエムケイ(株)(日本CMK、東京都新宿区西新宿6-5-1、03-3333-0231)は、2017年度第1四半期(4月6日)決算を発表した。売上高は前年同期比18%増の208億円、営業利益は同3.2倍の11.3億円の大幅増収増益となった。世界的に自動車の販売が

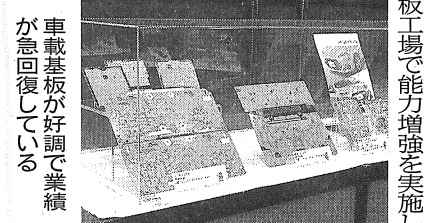
だが、今四半期は1米ドル=30.18台湾ドルと台湾ドルが高進行しており、為替差損を受けるかたじけなかった。米ドルベースの場合、今四半期の業

オルボテック

PCBなど増収増益

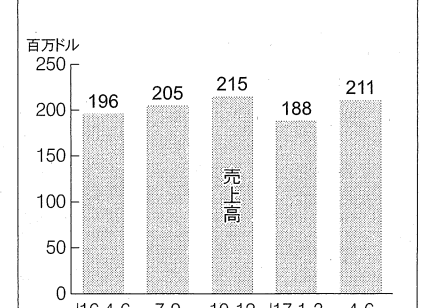
過去最高の受注水準

イスラエルのハイテク装置・検査メーカーのオルボテック(日本法人)東京都目黒区青葉台4-7-1



機器向けが堅調に推移、前年同期比35%増の40億円強を売り上げた。

オルボテックの四半期売上高



比7%増の2億1100万ドル、営業利益は同16%増の3100万ドルの増収増益となった。全事業部門において四半期ベースでは過去最高の受注水準を達成した。4~6月売上高のうち、PCB事業部門は8250万ドルとなり、FPD事業は6970万ドル、半導体デバイス(SD)事業は5490万ドルをそれぞれ計上した。SD事業を除き、PCBならびにFPD両事業は1年前に比較して増収した。関連業界の旺盛な投資を反映して製造装置・検査機などの販売が伸びた。

特に独自の光学系補正技術を使った微細な回路のリペア装置の受注が好調を維持しており、PCB事業を牽引している。同部門は、PCBの細線化要求とといった新技術への対応装置のラインアップを強化しており、4~6月は過去最高の受注水準を確保した。7~9月もこの流れを引き継ぎ、17年下期を通じて好調を維持する見通し。

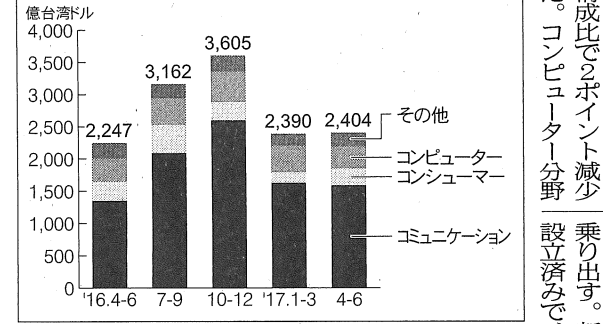
イベント

5G時代の実装

9月13日に開催

日本実装技術振興協会(高松市)は、第186回高密度実装技術部会(嶋田三郎部会長)は、9月13日(水)、13時、開催場所が東京工業大学蔵前会館(目黒区大岡山)。

ペガロンの四半期売上高と製品構成



構成比でポイント減少した。コンピュータ分野、通信分野、一部稼働した。関連投資額は17億台湾ドルとみられる。

インタビュー



アルファードデザイン(株) (長野県東御市滋野甲2-211-3、026-20208-64-0088)は、半導体用ボンディング装置、チップテーピング機など後工程装置を手がける中堅企業だ。半導体後工程装置を中心に、20

20年をめぐり今後グループ売り上げを現状の約2倍となる100億円に引き上げる意気込みを見せるなど、攻めの姿勢を貫く。17年7月に新たに代表取締役社長に就任した森澤修二郎氏に現況および今後の事業計画について話を聞いた。

森澤修二郎氏

売上高「20年めどに倍増の100億円」

TCB装置 パワーデバイスなどに活路

20年をめぐり今後グループ売り上げを現状の約2倍となる100億円に引き上げる意気込みを見せるなど、攻めの姿勢を貫く。17年7月に新たに代表取締役社長に就任した森澤修二郎氏に現況および今後の事業計画について話を聞いた。

購読のご案内

電子デバイス産業新聞

Electronic Device Industry News

発行：毎週木曜日

体裁：B3判(プランケット判)

購読料：64,000円+税/1年間(送料込)

お申込後請求書をご送付いたします。お支払いは、銀行振込・郵便振替となります。

以下の場合には富士山マガジンスペース(0120-223-223)(fujisan.co.jp)からお申込お願いいたします。

- 個人にご購読のお客様
- 購読期間3ヶ月・半年希望のお客様
- クレジットカード/コンビニ/Web口座振替にてお支払いのお客様

ご意見・ご要望 お問い合わせ先 販売部 Tel.03-5835-5892 産業44入社

半導体パッケージはどうなる 2017

～ファンアウト、2.5Dなど新技術が実用化、業界最前線を追う～

日時：2017年9月21日(木) / 10:00~18:00

会場：東京・富士ソフトアキバプラザ

10:00~10:50 「半導体/セット市況とパッケージ・OSAT業界」

電子デバイス産業新聞 副編集長 稲葉 雅也